

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2026022

# 大族激光科技产业集团股份有限公司

## 2025 年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,029,603,408 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	大族激光	股票代码	002008
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杜永刚	王琳	
办公地址	广东省深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心	广东省深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心	
传真	0755-86161327	0755-86161327	
电话	0755-86161340	0755-86161340	
电子信箱	bsd@hanslaser.com	bsd@hanslaser.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式

#### 1、主要业务、主要产品及其用途

公司是一家专业从事智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售的高新技术企业，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势，是全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商。

公司主要产品分为：通用元件及行业普及产品、行业专机产品、极限制造产品三大类。

##### （1）通用元件及行业普及产品

通用元件及行业普及产品为紫外及超快激光器、高功率光纤激光器、中低功率 CO<sub>2</sub> 激光器、脉冲光纤激光器、通用运动控制系统、振镜、伺服电机等工业激光加工设备及自动化设备的关键器件。

报告期内，公司通用元件及行业普及产品主要为集成在整机设备上一并销售，直接对外销售的规模较小。

##### （2）行业专机产品

行业专机产品为信息产业设备、新能源设备、半导体设备等行业专用设备。该类产品行业特性强，产品之间差异较大，需要根据客户的特定需求进行个性化设计、定制，受下游客户所处行业影响较大。

##### 1) 信息产业设备

消费电子设备：主要产品为专用激光打标设备、激光焊接设备、激光钻孔设备、防水气密性检测设备、CNC 数控机床等，用于手机、笔记本电脑、智能手表等消费电子产品的生产加工环节。

PCB 设备：主要产品为钻孔设备、激光直接成像设备、成型设备以及检测设备等，面向钻孔、曝光、成型、检测等 PCB 生产的关键工序。

##### 2) 新能源设备

锂电设备：主要产品为匀浆、搅拌、涂布、辊压、模切、分切、卷绕/叠片、电芯组装、烘烤、注液、化成分容等加工设备及自动化生产线，用于锂电池电芯、模组、PACK 段的生产加工环节。

光伏设备：主要产品在光伏电池及组件环节，包括 TOPCon 电池生产主设备：激光硼掺杂设备、PECVD（等离子增强气相沉积设备）、LPCVD（低压化学气相沉积设备）、扩散炉、氧化炉、退火炉，以及组件段的无损划片机、划焊一体机等。

##### 3) 半导体设备

主要产品为激光表切、全切设备，激光内部改质切割设备等前道晶圆切割设备，及焊线设备、固晶设备、测试编带设备等后道封测设备及晶圆自动化传输设备，用于半导体及 LED、显示面板等泛半导体的生产加工环节。

##### （3）极限制造产品

极限制造产品为标准激光切割、焊接、打标设备等通用激光加工设备。通用激光加工设备主要应用于金属及非金属材料的工业加工环节，凭借速度快、精度高、加工质量好等优势，逐步替代传统机械加工设备，大幅提高了工业加工效率和品质。该业务的下游相对广泛且分散，应用于工程机械、建设机械、汽车配件、厨卫五金、电子电气、智能家居等多个行业。

现阶段，行业专机和极限制造产品仍是公司主要的收入与利润来源。公司研发生产的紫外及超快激光器、高功率光纤激光器、中低功率 CO<sub>2</sub> 激光器、脉冲光纤激光器、通用运动控制系统、振镜、伺服电机等通用元件及行业普及产品已全面推向市场，有望成为公司新的业绩驱动因素。

### 2、经营模式

#### （1）生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，具体为：供应链与交付平台结合需求预测、意向订单、实际订单、备货情况及产能等情况，按月编制《整机计划》，按 BOM 组织物料，由生产部门按作业指导书进行模块化组装，再进行总装调试。公司制定了《生产运行控制程序》、《生产及物料计划管理规定》、《产品测量与监控程序》等制度，从来料、半成品、装配过程、成品入库、出货等多方面对产品进行质量检测及品质把控。

#### （2）采购模式

公司主要采用“以产定采”辅以“安全库存”的方式开展生产性物料的采购，主要采购类别包括钣金机加件、机械器件、外购模组、光学器件等。公司按照供应商管理办法，根据物料特性开发供应商，通过审厂、样品测试等方式对

供应商资质进行审核，被纳入合格供应商名录的企业还需接受定期考核及复审。公司采用询价采购或年度框架协议等模式，按照原材料性质，从合格供应商库中选择合适供应商进行采购。对于标准部件，公司主要结合原材料的质量、价格、交期等因素进行采购；对于非标准化部件，公司会对部件进行自主设计后，根据供应商的技术水平、加工能力和报价等因素择优确定。

公司根据各类物料的采购周期以及《整机计划》进行原材料备货，对于核心物料、贵重物料每个月根据市场发机计划安排提货；对于辅料类按照安全库存模式进行备货。公司与供应商在采购合同中会约定不同的信用政策，并主要通过银行转账、承兑汇票等方式与供应商结算。

### (3) 销售模式

公司在国内市场主要采取直销模式，与主要客户建立了长期稳定的合作关系，公司根据产品的应用领域和市场特点，借助产品和技术优势不断拓展国内外行业知名客户资源，深入挖掘客户需求，获取市场业务机会，将公司生产的各类智能制造装备，以直销方式销售给国内客户。境外销售采用直销模式和代理销售模式。直销模式方面，公司与境外客户签订合同，由公司进行报关发货后交付至客户；代理销售模式方面，公司采用代理商销售模式和贸易商销售模式开拓境外业务。由于部分代理商和贸易商具有丰富的客户资源，公司为提升与该等客户的合作深度，争取更多的市场份额，与代理商和贸易商建立了长期合作关系。代理商与公司签订长期代理协议，向公司提供市场和客户信息，推荐意向客户，公司与客户商谈后签署销售合同。贸易商与公司签订采购合同，向公司采购产品后通过自有销售渠道将产品销售给其客户。

## (二) 报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素

公司经过了近三十年的发展和技术积累，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化能力，是全球领先的智能制造装备整体解决方案提供商。

2025 年度营业收入 1,875,886.61 万元，营业利润 155,146.60 万元，归属于母公司的净利润 118,968.43 万元，扣除非经常性损益后净利润 81,047.91 万元，分别较上年同期增减 27.00%、-14.56%、-29.77%、82.28%。

报告期内，公司主要收入来自于行业专机产品及极限制造产品，具体情况如下：

### 1、信息产业设备业务受益于 AI 带动，开始新一轮强势增长

报告期内，公司信息产业设备业务实现营业收入 82.45 亿元，同比增长 50.28%。其中，消费电子设备业务实现营业收入 24.72 亿元，同比增长 15.33%。全球消费电子行业正经历新型智能终端爆发的变革，手机、眼镜、终端智能体等智能硬件加速创新。公司深度参与多家海外客户创新产品开发，已成功助力客户攻克多项制造难题：先后在散热、光学组件、金属 3D 打印等智能手机项目，金属焊接、锡膏锡球焊接、CCD/AOI 检测等智能眼镜项目，精密部件组件焊接等项目上提供行业领先解决方案和配套量产设备。基于在高端制造领域的深厚积累，公司 3D 打印业务已与 3C 消费电子领域的龙头企业建立长期深度合作，聚焦新材料、新结构等前沿方向开展联合技术攻坚，3D 打印环形光束技术凭借能量分布特性，在保障成型质量的前提下，显著缩短扫描路径减少重复加工程序，系统性提升打印效率，为 3C 消费电子制造开辟了一条更高效、更可控、更具成本优势的全新路径。红光/绿光金属 3D 打印设备采用全自主研发的一体化架构，可稳定打印纯铜、铜合金等高反材料，满足 3C 电子、航空航天、医疗齿科等领域复杂部件需求。3D 打印技术凭借在复杂设计、轻薄化和 ESG 等方面的优势，有望推动新一轮扩产周期。

PCB 设备业务实现营业收入 57.73 亿元，同比增长 72.68%。公司在 AI 算力 PCB 专用设备市场快速崛起，主要产品市场占有率及客户认可度持续攀升，公司紧抓 AI 算力 PCB 行业成长机遇，积极研发创新型解决方案，同步提升产能和产品品质，赋能 PCB 产业快速扩产及技术升级，公司各类产品营收取得较大幅度增长。在高多层板市场，AI 算力中心数据量大幅攀升，AI 服务器、高速交换机等产品对信号完整性及电源完整性的保障提出更高要求，公司 CCD 六轴独立机械钻孔机搭载自主专利的 3D 背钻及钻测一体技术，可实现超短残桩和超高同心度，已完成下一代 AI 服务器 PCB 的加工认证，并在行业多家高多层板龙头企业实现量产；HDI 板市场方面，增长最为显著的 AI 服务器相关高多层 HDI 板，其结构更加复杂，公司持续与下游客户开展新材料加工工艺研究，是行业内少数可提供对应成套解决方案的企业，针对该类产品技术难度大、特征参数小的特点，提供机械钻孔机、CCD 六轴独立机械钻孔机、CO<sub>2</sub> 激光钻孔机、新型激光钻孔机的超强产品组合，不断巩固公司在钻孔这一核心工序的市场地位；先进封装方面，公司一方面不断提升传统解决方案产品的性能，另一方面，从先进封装技术快速发展入手，提供更小微孔钻孔、更高精度挖槽及成型、无损玻璃基板通孔、裂片加工等系列产品，相较于国外设备厂商的传统产品方案，公司创新产品具有品质和效率方面的双重优势，

收获国内外龙头封装基板及终端客户的认可，并赋能国内相关下游客户向先进封装市场拓展；传统 PCB 市场方面，市场充分竞争，下游客户亟需可降本增效的加工方案来提升自身竞争力，公司在该市场不断提升各产品的综合性能，持续降低下游客户的制造成本。

## 2、新能源设备业务收入大幅增长，持续发力大客户及海外业务

报告期内，公司新能源设备业务实现营业收入 23.61 亿元，同比增长 53.36%。其中，锂电设备业务实现营业收入 22.56 亿元，同比增长 49.65%。在全球新能源产业“技术迭代+出海扩张”双周期驱动下，众多行业客户开始启动新一轮扩产投产计划，带动设备需求同步上涨。在国内锂电设备行业需求稳步增长的同时，大客户对海外扩产的需求亦带动了锂电设备需求的增长，公司紧跟大客户的扩产步伐，在深化大客户国内合作的同时，配合大客户的生产节奏，积极拓展海外市场业务，实现销售额显著增长。公司积极配合宁德时代、中创新航、亿纬锂能等头部客户国内扩产项目，同步配套其海外建设，抓住新能源市场全球化发展机遇，通过属地化团队规避贸易壁垒，进一步提升动力电池和储能电池装备业务的市场竞争力和市场占有率，并通过加强创新技术研发和精细化管理等多种方式，持续优化盈利结构。新设备技术研发方面，公司成功开发圆柱电池侧焊封口设备，突破现有技术瓶颈，采用高速凸轮转塔连续生产工艺与 3D 振镜飞行焊技术，显著提升焊接精度与效率，设备一次良率达到 96%。同时，针对小钢壳电池结构特点，提供定制化设计方案，开发了 QCW150 激光器焊接工艺，实现了如 TAP 片高速螺旋焊接、密封钉脉冲点焊及壳体快速连续焊接等多种工艺应用。

## 3、半导体设备业务平稳增长，先进技术开始落地

报告期内，公司半导体设备（含泛半导体）业务实现营业收入 20.41 亿元，同比增长 15.00%。大族半导体实现营业收入 13.78 亿元，同比增长 23.89%。全球半导体及 LED 封装设备行业呈现分化态势，LED 市场景气度不足，延续下行趋势；半导体缓慢复苏，但结构分化明显。公司面板行业激光打孔项目首台设备完成客户验收，成功取得客户复购订单，单台设备金额达到 1 亿元；激光修复机、激光剥离机、平板显示器基板切割机及设备多次中标京东方 AMOLED 生产线项目，激光切除机中标华星光电氧化物半导体新型显示器件生产线项目，获得行业龙头客户认可。存储行业多款产品在客户现场验证通过并取得复购订单，取得较大突破；SiC 剥片设备成为行业主流选择，自主研发的全新金刚石激光剥离工艺实现产品化，并已在客户现场完成批量有效剥片生产；先进封装解键合成为行业第一选择，晶圆级、面板级激光解键合及清洗系列设备国内市场份额稳居前列。

大族封测 LED 封装业务受终端需求减弱及市场竞争等影响，客户扩产意愿减弱，设备采购以存量替换和技术升级为主。H582 系列焊线机凭借在稳定性上的优势，成为老旧进口设备替换的首选；针对下一代户内显示高精度需求，新一代高性能平台 H58X 系列设备牢牢锁定高端存量市场，已获得行业龙头企业的意向订单；在功率半导体领域，针对功率器件的专用机型实现批量销售；依托核心运动控制平台、精密平台等技术，孵化点胶机和精密微组装机等业务，为客户提供一站式组装连接的专用设备。

大族富创得深耕半导体晶圆自动化搬运领域，并逐步将业务拓展至光罩、玻璃基板搬运等相关环节，为客户提供整体解决方案，已与国内外许多头部 FAB 厂建立了广泛业务合作。受益于部分下游客户扩产需求及新产品突破，EFEM（设备前端模块）、SMIF（标准机械接口晶圆盒）、SORTER（分选机）等产品实现了高速增长。

## 4、通用工业激光加工设备市场需求稳中向好，收入及盈利持续改善

报告期内，通用工业激光加工设备业务实现营业收入 61.12 亿元，同比增长 2.37%。公司持续聚焦切割、切管、折弯、焊接、打标及自动化等整机领域，同时在激光器、切割头、数控系统等核心功能器件上深耕细作，持续开展技术升级与产品迭代。通过不断驱动核心器件升级与整机性能提升，积极推动器件与整机协同创新，公司技术优势与市场竞争力进一步增强，推动创新势能不断转化为市场竞争优势。在产能与布局层面，公司进一步深化多工厂战略布局，提升区域市场响应能力；同时持续拓展全球业务网络，推动海外市场份额稳步提升。在市场与品牌方面，深化与战略伙伴合作，提升全球影响力，并持续开拓新项目、新客户。在海外市场方面，继续深化全球化战略，加速构建辐射全球的营销服务网络，依托本土化运营与快速响应机制，为全球客户提供更及时、专业的服务保障与技术支持。

高功率设备实现业务收入 31.63 亿元，同比下降 6.60%。激光切割焊接行业充分竞争，市场格局快速演变。面对外部复杂环境，公司坚持研发创新，紧密围绕客户及市场需求，不断优化升级产品，深挖国内存量市场，实现大规模市场推广与销售放量，高功率切割业务实现销售台数 6800 台，同比增长 30.47%，实现业务收入 25.33 亿元，同比增长 4.25%。产品方面，迭代速度加快，技术创新成为行业竞争的焦点，客户对产品性能、质量、服务的要求进一步提升。公司自主研发的三维五轴切割头升级产品已小批量投入市场，性能提升显著，已成为行业标杆产品；40KW 切割头销售数量实现

三倍增长，60KW 切割头实现十倍增长。高功率万瓦级激光焊机顺利完成 40KW（首台套）交付，融合双自动化协同控制、焊缝实时跟踪、熔池监测等多项功能，达到高效、稳定、精准的生产效果。公司持续推动高端装备矩阵的完善与智能化升级，相继推出 GPRO 系列高速激光切割机、F1 高速激光切管机及海外版大幅面激光切割机，MLU 系列柔性自动化生产线显著拓展了智能化解决方案的应用边界，40kW~60kW 超高功率激光切割机持续稳居市场前列。

小功率设备实现业务收入 29.49 亿元，同比增长 14.12%。公司在中低功率五金焊接、CO2 服装辅料、特种焊接、紫外及超快激光器应用等领域的设备销售额取得 40%以上的显著增长，整体实现销售收入 16.1 亿元，同比增长 30%；在守住成熟应用行业的同时，公司持续开拓热点市场，牢牢把握拓展连接器、智能穿戴、汽车电子等重点行业机遇，积极布局推广自动化解决方案，在连接器行业销售收入录得 47%增长，汽车电子自动化行业销售收入录得 197%的大幅增长。公司在脉冲光纤激光器、中低功率激光焊接、掺镱固体激光器、CO2 激光器等产品领域均取得技术突破并获广泛认可，9.3um 波长系列 CO2 激光器国内各主要应用场景均处于垄断地位，产品性能优于进口同类产品性能；自主研发生产的 200W 绿光光纤激光器在重点客户处得到验证，应用效率和效果行业领先；PG5 系列成为国内唯一量产长脉冲绿光焊接光源，单一客户出货量超百台，在高速连接器行业崭露头角。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	38,248,456,805.92	34,227,059,742.80	11.75%	34,200,363,737.11
归属于上市公司股东的净资产	17,283,032,015.02	16,138,927,404.74	7.09%	15,000,349,121.49
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	18,758,866,083.94	14,771,215,354.04	27.00%	14,091,101,814.42
归属于上市公司股东的净利润	1,189,684,341.25	1,693,900,253.05	-29.77%	820,218,770.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	810,479,085.79	444,633,990.18	82.28%	465,048,324.52
经营活动产生的现金流量净额	1,469,219,991.65	1,126,050,737.62	30.48%	1,362,628,841.47
基本每股收益（元/股）	1.15	1.62	-29.01%	0.78
稀释每股收益（元/股）	1.15	1.62	-29.01%	0.78
加权平均净资产收益率	7.19%	10.95%	-3.76%	5.61%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,943,580,546.79	4,669,266,867.34	5,099,975,498.09	6,046,043,171.72
归属于上市公司股东的净利润	163,470,377.43	324,686,366.35	375,220,355.19	326,307,242.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,901,945.12	189,161,133.97	307,332,458.11	242,083,548.59
经营活动产生的现金流量净额	-656,985,386.57	-65,486,304.92	-139,897,225.84	2,331,588,908.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股 股东总数	100,643	年度报告披露日前一个 月末普通股股东总数	75,877	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表 决恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.71%	161,773,306	0	质押	102,830,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	10.48%	107,878,781	0	不适用	0	
高云峰	境外自然人	9.36%	96,319,535	72,239,651	质押	89,180,000	
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.50%	25,782,624	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	12,177,186	0	不适用	0	
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.05%	10,784,146	0	不适用	0	
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	其他	0.93%	9,623,322	0	不适用	0	
全国社保基金五零二组合	其他	0.68%	7,019,853	0	不适用	0	
安耐德合伙人有限公司－客户资金	境外法人	0.68%	6,956,400	0	不适用	0	
杜远	境内自然人	0.62%	6,420,020	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明			大族控股集团有限公司之控股股东系高云峰，高云峰与大族控股集团有限公司系一致行动人				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

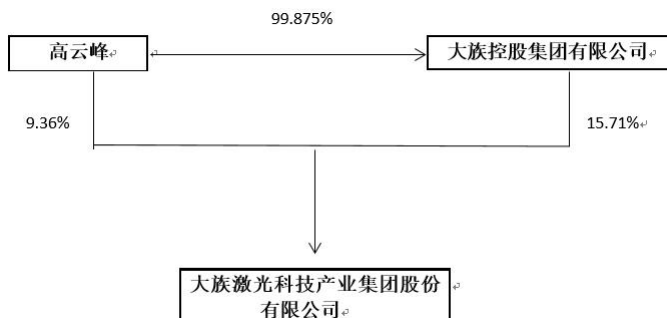
适用 不适用

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

##### (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

1、2025 年 1 月 27 日，公司按照经第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》完成股份回购，具体请参阅公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025010）。回购实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,589,592 股，占公司当时总股本比例为 2.15%，支付的资金总额为人民币 500,244,727.76 元（不含交易费用）。

2、公司分别于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 5 月 12 日召开第八届董事会第五次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”的股份之用途变更为“用于注销以减少注册资本”。公司本次将注销的回购股份共计 22,589,592 股，占公司注销前总股本比例为 2.15%。具体内容详见 2025 年 4 月 3 日及 2025 年 5 月 13 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025016）及《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025036）。

3、2025 年 7 月 1 日，根据《关于变更回购股份用途并注销的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司注销回购股份 22,589,592 股，占公司本次注销前总股本的 2.15%。回购股份注销完成后，公司总股本由注销前的 1,052,193,000 股变更为 1,029,603,408 股。2025 年 7 月 23 日，公司完成办理由本次股份注销而导致的注册资本变动及《公司章程》修改的工商登记。

4、2025 年 4 月 2 日，公司子公司大族数控召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于同意公司研究论证公司境外发行证券（H 股）并上市事项的议案》，对境外发行证券（H 股）并上市事项进行前期论证。2025 年 4 月 17 日，公司子公司大族数控召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，为进一步推进全球化战略，提升大族数控在国际市场的综合竞争力，大族数控拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。2025 年 5 月 30 日，公司子公司大族数控向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市之申请文件，大族数控本次发行上市尚需满足多项条件（包括但不限于，取得中国证监会的备案、香港联交所及其他有关监管机构的批准等），并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，尚存在一定不确定性。2026 年 2 月 6 日，大族数控在香港联交所主板挂牌并上市交易，共发行 50,451,800 股 H 股股票（行使超额配售权之前），大族数控 H 股股票中文简称“大族数控”，英文简称“HANS CNC”，股票代码“03200”。大族数控本次发行上市后，公司仍将维持对大族数控的控制权。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2026 年 4 月 17 日